

HENKEL SOLUTIONS FOR AUTOMOTIVE ELECTRONICS COMPONENTS

BERGQUIST® GAP FILLER TGF 4400LVO

新製品 2液性、低揮発性シリコンベースのギャップフィラー



特性・利点

- 2液 低揮発性 シリコン技術
- 組付け時の厚みを薄くできるため熱抵抗を最適化した設計が可能
- 可使時間 (90 分) と 硬化時間(< 12 時間@室温) のバランスが良い
- 熱伝導率代表値が 4.4 W/(m.K)
- 迅速で確実な 塗布特性
- 厳しい熱負荷環境下での優れた信頼性



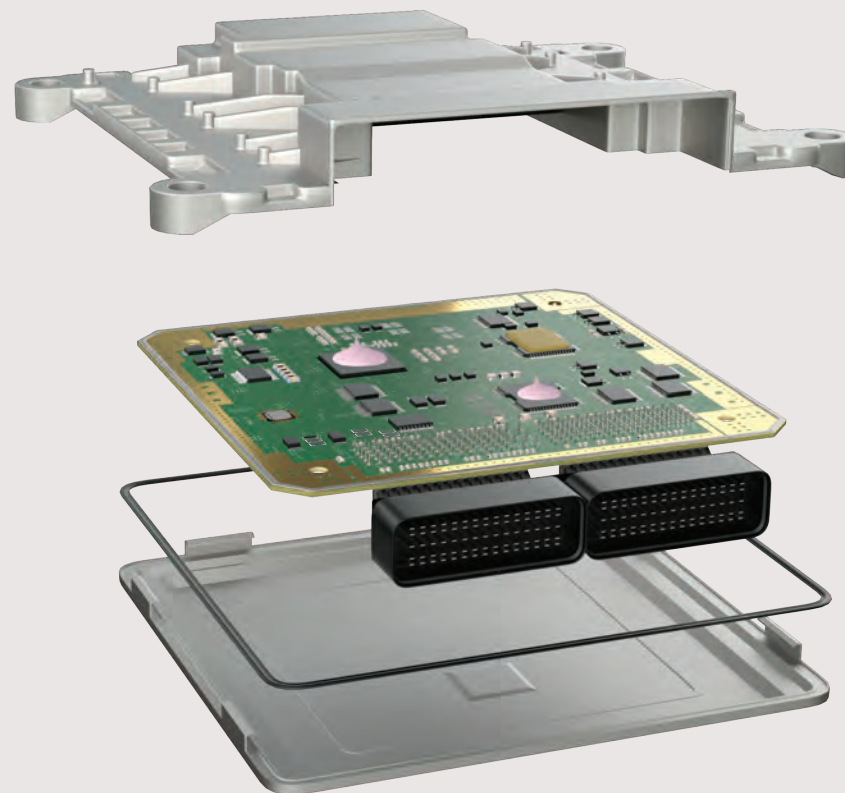
サステナビリティ

- 可使時間が長いいため プロセスに柔軟性ができ、生産ラインにおける材料のスクラップ率が低減
- 低分子シロキサン対策品

ヘンケルの幅広い技術ポートフォリオとアプリケーションノウハウをぜひご活用ください！



Henkel Adhesive Technologies



BERGQUIST® GAP FILLER TGF 4400LVO

新製品 2液性、低ガス揮発性シリコンベースギャップフィラー

利点

- アウトガスを抑えた低揮発性シリコン
- 優れた垂直ギャップ安定性による長期信頼性と性能
- 圧縮後薄膜であることが必要なアプリケーションに最適:
 - 熱抵抗を低減
 - 様々なギャップに対応できるため設計の柔軟性が向上
- 高スループット製造を可能にする高い吐出安定性
- 優れたウェットアウト性により低熱抵抗インピーダンスを実現

製品性能

ベースケミカル	シリコン(2液)
熱伝導性, ASTM D5470	4.4 W/(m.K)
シオア硬度 (00)	90
吐出性(EFD 30 cc, 90 psi)	Part A: 1.0 cc/sec; Part B: 1.2 cc/sec
硬化方法	室温硬化または熱硬化*
可使時間	90 分@ 25°C

*塗布についてのご相談は専門のアプリケーションエンジニアが対応いたします。

お問い合わせはヘンケルの車載エレクトロニクス専任セールスエンジニアまで。

問い合わせは下記へ

ヘンケルジャパン株式会社

オートモーティブコンポーネンツ事業部

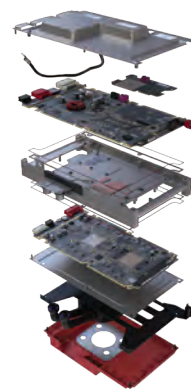
〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7

TEL : 045 (758) 1800

製品に関するお問い合わせは Webmaster.LJapan@henkel.com

代表的アプリケーション

- 車載コントロールユニット、ADASカメラ、LiDAR、データモジュール、ディスプレイ
- 車載エレクトロニクス部品で高速処理プロセスが必要な用途



販売容器サイズ

- 50cc, 400cc, 1200 cc カートリッジ
- 20Lペール缶



www.henkel-adhesives.com

The data contained herein is intended as reference only. Some products / package sizes may not be available in your country or may have a lead time. Please contact your local Henkel subsidiary for assistance and recommendation on specifications and applications of these products. © designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere
© Henkel AG & Co. KGaA, 2023 (10/2023)

